

第 45 回 電子デバイス実装研究委員会



日時：2023 年 11 月 21 日（火）13:00～16:45

場所：日本橋ライフサイエンスビルディング 9 階 911-913 会議室（東京都中央区）

プログラム

司会 岩田 剛治（大阪大学）

13:00～13:10 委員会議事

13:10～13:50

『機械学習×伝熱工学による温度予測式の自動生成技術』（40 分）

.....○鈴木 智之, 廣畑 賢治, 伊藤 安孝（株式会社 東芝）

13:50～14:30

『“AI” inside “X”=スマートプロセス

～AI inside が取り組むものづくり現場への AI 導入事例の紹介～』（40 分）

.....○井上 拓真, ○藤本 智大, ○佐々木 章宏（AI inside 株式会社）

14:30～14:45 休憩

司会 作山 誠樹（富士通 株式会社）

14:45～15:25

『はんだ付け性試験の濡れ性挙動に基づく新規前処理の検討』（40 分）

.....○泉水 崇彰, 長居 秀幸（TDK 株式会社）

15:25～16:05

『半導体集積化に向けた 3 次元集積実装技術の研究開発について』（40 分）

.....○菊地 克弥（国立研究開発法人 産業技術総合研究所）

16:05～16:45

『シリコンブリッジパッケージングに向けたアンダーフィル充填技術』（40 分）

.....○丸島 千波, 渡邊 敬仁, 青木 豊広, 宮澤 理沙, 中村 光希, 堀部 晃啓

（日本アイ・ビー・エム株式会社）

（ ）内時間は、質疑応答時間を含む

※プログラムは、都合により若干変更になることがありますので、予めご了承下さい。

※本研究委員会の資料を無断で転載、引用することを禁止します。
一般社団法人スマートプロセス学会 エレクトロニクス生産科学部会